

HST-T02 热封试验仪



一、产品简介

HST-T02 热封试验仪采用热压封口法的测试原理,适用于测定软包装复合膜、塑料薄膜基材、涂布纸及其它热封复合膜的热封压力、热封温度和热封时间等参数,是实验室、科研、在线生产中不可缺少的试验仪器,也称为热合强度测定仪、热封性能测试仪和热封强度试验机等。

二、技术指标

序号	项目	参数
1	热封温度	室温-300℃
2	热封压力	50-700kpa(取决于热封面积)
3	热封时间	0.1-999.9s
4	控温精度	±0.2℃
5	热封面积	330x10mm(可定制)
6	加热形式	双加热(可独立控制)
7	气源压力	0.7-0.8Mpa(气源用户自备)
8	气源接口	φ6mm 聚氨酯管
9	电源	AC 220V 50Hz / AC 120V 60Hz
10	外形尺寸	448x338x425mm
11	重量	45kg

三、测试原理

HST-T02 采用热压封口法,将待封试样置于上下热封头之间,在预先设定的温度、压力和时间下,完成对试样的封口,通过在不同的温度、压力和时间等试验条件下对试样热封合,即可获得试样合适的封装工艺。

四、试验标准

QB/T 2358、ASTM F2029、YBB 00122003

五、应用

基础应用	薄膜材料	用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、镀铝膜、铝箔、共挤膜、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验，热封宽度可以根据用户的需求进行设计
扩展应用（选配/定制）	果冻杯盖	把果冻杯放下下封头的开孔中，下封头的开孔和果冻杯的外径配合，杯口的翻边落在孔的边缘，上封头做成圆形，下压完成对果冻杯的热封
	塑料软管	把塑料软管的管尾放在上下封头之间，对管尾进行热封，使塑料软管成为一个包装容器

六、产品特点

- 热封温度 PID 控制，有效提升温度的控制精度
- 手动和脚踏两种试验启动模式以及防烫伤安全设计，可以有效保证用户使用的方便性和安全性
- 热封压力、热封温度和热封时间等参数皆可预设，直接输入数值，即可进入试验模式
- 关键元器件选用世界知名品牌进口件，保证系统的精度和稳定性
- 进口高速高精度采样芯片，保证测试数据的实时性和准确性
- 大尺寸高清彩色液晶屏，方便用户控制和展示实时数据及曲线
- 支持历史数据可进行快速查看

七、产品配置

标准配置：主机、内嵌软件、脚踏开关

选购件：专业软件、通信电缆、微型打印机

备注：本机气源接口系Φ6mm 聚氨酯管；气源用户自备